

# EPTC 2018

20<sup>th</sup> Electronics Packaging Technology Conference  
4<sup>th</sup> – 7<sup>th</sup> Dec 2018, Resorts World Sentosa, Singapore

IEEE EPS Flagship Conference  
In Asia Pacific Region

## 论文征集

### 会议简介

第二十届电子封装技术会议 (EPTC 2018) 是由国际电气电子工程师协会电子封装学会 (IEEE RLS/EPS/EDS) 新加坡分会主办, 并由国际电气电子工程师协会电子封装学会赞助的国际会议。

会议将会以特邀报告、分会报告、专题讲座、主题论坛, 展板展示和社交网络活动等形式交流电子封装技术领域从设计, 制造到生产等全方位的最新进展。本会议将为来自海内外学术界和工业界的专家、学者和研究人员提供电子封装与制造技术新进展、新思路的学术交流平台。另外, 本届年会是电子封装技术会议的二十周年华诞, 为庆祝这一特别节日, 额外一天的特殊庆祝活动将会加入今年的会议流程。

自从 1997 创会以来, EPTC 已经发展成为在亚太地区享有盛名的电子封装技术会议。每一届会议都吸引了大批世界各地的封装行业的专家参加。该会议已经成为电子封装学会在亚太地区 (Region 10) 的旗舰会议。

### 会议主题

欢迎大家热烈投稿来介绍下列课题方面的新发展:

- **先进封装:** 先进倒装芯片封装, 2.5D & 3D, 叠成封装, 嵌入被动和主动元件基板, 系统集成封装 (SiP), 嵌入芯片级封装技术, 面板级封装, 射频, 微波和毫米波, 功率和坚固电子封装 等等。
- **硅通孔 (TSV) / 晶圆级封装:** 晶圆级封装 (扇入 / 扇出), 嵌入芯片级封装技术, 2.5D/3D 集成, 硅通孔, 硅和玻璃载板, 重分布制程, 凸块技术, 等等。
- **互连技术:** 金 / 银 / 铜 / 铝打线接合 / 楔型接合技术, 倒装芯片和铜柱, 焊料替代品 (ICP, ACP, NCP, ICA), 铜对铜, 晶圆级接合, 芯片贴装 (无铅) 等等。
- **新兴技术:** 微纳机电系统 (MEMS/NMES) 封装技术, 生物医学, 光电子, 物连, 光伏, 印刷电子, 穿戴设备电子, 光子, LED, 等等。
- **材料与工艺:** 先进材料, 比如 3D 材料, 先进封装用的光刻胶, 聚合物电介质材料, 焊料材料, 芯片贴装材料, 底部填充剂, 基板, 引线框架, 印刷电路板等等以及先进材料的装配工艺个。
- **设备, 流程开发和自动化:** 工艺开发, 设备自动化, 新工艺和技术, 设备改进, 数据分析, 数据采集计量。
- **电力仿真和表征:** 电源层模拟, 信号完整性仿真, 表征及分析, 2D/2.5D/3D 组装级高速信号传输设计, 表征和测试方法。
- **机械模拟和表征:** 热机械, 潮湿, 断裂, 疲劳, 振动, 冲击和跌落冲击建模和表征, 芯片封装交互影响等等。
- **热表征和冷却方案:** 热建模和仿真, 冷却解决方案, 组件、系统和产品级热管理和表征
- **质量, 可靠性和失效分析:** 组件, 插件板, 系统和产品级的可靠性评估, 界面粘合, 加速测试, 和失效表征等等。

也欢迎其他课题方面的投稿, 譬如, 市场趋势, 环境, 立法, 专利, 教育和成本方面的分析。

### 重要日期

开始在线提交摘要日期	2018年3月30日
摘要投稿截止日期	2018年6月15日
摘要接收通知日期	2018年7月15日
提交全文原稿日期	2018年9月15日

### 摘要和论文提交

论文摘要内容应属于原创的没有发表过的技术成果。论文摘要用至少 500~700 字的篇幅清楚地描述试验目的、结果 (包括数据、图表和图片) 和结论。论文摘要还应包括关键的参考文献。作者可以选择以大会发言或者展板展示的方式来发表论文。被接受并注册在大会发表的论文有资格由 IEEE Xplore 出版。**论文摘要和全文一律按 IEEE 的格式用英文书写并通过在线系统提交。所有的大会发言和展板展示都以英文进行。**有关摘要在线提交系统的信息可以在会议网站中找到 (<http://www.eptc-ieee.net>)。文件格式可以用 PDF 或 word 文档格式并以单一文件提交。

论文摘要提交截止日期是 2018 年 6 月 15 日。来稿请注明您的工作单位和联系方式, 包括电子信箱、邮编、通讯地址和您的联系电话。作者会在 2018 年 7 月 15 日前收到论文录用通知。2018 年 9 月 15 日以前提交的全文原稿才能录入会议论文集。会议论文集是正式的 IEEE 出版物, 被录用论文可以在 IEEE Xplore 上获取。

### 最佳论文奖

最佳论文奖包括: 最佳大会发言论文 (学术界), 最佳大会发言论文 (工业界), 最佳大会发言论文 (学生), 最佳展板展示论文 (所有论文)。具体细节请参考会议网站: <http://www.eptc-ieee.net>

### 征集专题课程

会议中包括的专题课程将由在该领域中的专家来主讲。细节到时候会在会议网站中公布。对专题课程的提议可以通过电子邮件发送到 [pdcc@eptc-ieee.net](mailto:pdcc@eptc-ieee.net)

### 征集展览/赞助商

会议期间, 还有由微电子封装和装配业界的材料供应商, 设备供应商和服务供应商组成的台面展览。如果要了解展览详情, 请发送电子邮件到 [exhibition@eptc-ieee.net](mailto:exhibition@eptc-ieee.net) 和 [sponsorship@eptc-ieee.net](mailto:sponsorship@eptc-ieee.net)。

EPTC 2018: 网站: <http://www.eptc-ieee.net> 电子邮箱: [secretariat@eptc-ieee.net](mailto:secretariat@eptc-ieee.net) 加入我们: [Linkedin \[EPTC OC\]](#)



IEEE Reliability/EPS/ED Singapore Chapter

General Chair  
Vempati Srinivasa Rao  
IME  
[generalchair@eptc-ieee.net](mailto:generalchair@eptc-ieee.net)

Technical Chair  
Wong Wui Weng  
AMD  
[techchair@eptc-ieee.net](mailto:techchair@eptc-ieee.net)

Program Chair  
Navas Khan  
Infineon  
[program@eptc-ieee.net](mailto:program@eptc-ieee.net)

Sponsored by

